# Теплопроводность "легкой" тяжелофермионной системы YbMgCu4

© А.В. Голубков, Л.С. Парфеньева, И.А. Смирнов, Н. Misiorek\*, J. Mucha\*, A. Jezowski\*

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук,

194021 Санкт-Петербург, Россия

\* Institute of Low Temperature and Structure Research, Polish Academy of Sciences,

50-950 Wroclaw, Poland

E-mail: igor.smirnov@mail.ioffe.ru

(Поступила в Редакцию 2 апреля 2007 г.)

В интервале температур 5–300 К измерены теплопроводность и удельное электросопротивление образца YbMgCu<sub>4</sub>, относящегося к "легким" тяжелофермионным соединениям. Исследованый образец располагался в области гомогенности этого соединения. Показано, что его фононная теплопроводность во всем исследованном интервале температур имеет "аморфноподобный" вид, обусловленный наличием в YbMgCu<sub>4</sub> гомогенной валентности иона Yb.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 05-02-17775) и проводилась в рамках двустороннего научного соглашения между Польской и Российской академиями наук.

PACS: 71.27.-a, 65.40.-b

### 1. Введение

Тяжелофермионные соединения (ТФС) YbMCu<sub>4</sub> (M = Ag, Au, Cd, In, Mg, Tl, Zn), кристаллизующиеся в гранецентрированной кубической решетке типа AuBe<sub>5</sub> (структура C15b, пространственная группа  $F\bar{4}3m$  ( $T_a^2$ )), обладают весьма необычными физическими свойствами [1-6]. Они входят в группы "легких" ("light") и "умеренных" ("moderate") ТФС. Параметр у — коэффициент при линейном члене по температуре электронной составляющей теплоемкости ( $C_e = \gamma T$ ), пропорциональный эффективной массе носителей тока, — расположен у этих соединений в интервале  $50-400 \text{ mJ/mol} \cdot \text{K}^2$ (материалы с  $\gamma > 400$ , ~ 50–60 и 100–400 mJ/mol · K<sup>2</sup> относятся соответственно к классическим, "легким" и "умеренным" ТФС). Значения температуры Кондо  $(T_{\rm K})$ у ҮbMCu<sub>4</sub> лежат в интервале 60-800 К [2-4]. Эти соединения принадлежат также к интересному классу материалов с переменной валентностью (V) редкоземельных ионов (в данном случае иона Yb).

Изоструктурный фазовый переход первого рода при атмосферном давлении в ряду соединений YbMCu4 наблюдается лишь у YbIn<sub>1-x</sub>Cu<sub>4+x</sub>. Он происходит при  $T_v \sim 40 - 80 \, {
m K}$  (в зависимости от величины x) и сопровождается изменением валентности Yb для состава с x = 0 от 2.9 (при  $T > T_v$ ) до 2.85 (при  $T < T_v$ ). Полуметаллическая высокотемпературная фаза относится к кюри-вейссовским парамагнетикам с локализованными магнитными моментами. Металлическая низкотемпературная фаза является паулиевским парамагнетиком с немагнитным состоянием Ферми-жидкости. Она принадлежит к классу "легких" тяжелофермионных систем с  $\gamma \approx 50 \,\text{mJ/mol} \cdot \text{K}^2$ . У других соединений, входящих в систему YbMCu<sub>4</sub>, фазовых переходов в интервале 4.2-300 К не наблюдалось. Свойства, характерные для ТФС, у них проявляются при низких температурах. С изменением температуры от низкой к высокой в системе f-электронов Yb этих материалов происходит постепенный переход от состояния Ферми-жидкости к локальному состоянию (т.е. имеет место постепенный переход ТФС к обычному металлу, в котором, однако, ионы Yb продолжают оставаться в состоянии с переменной валентностью) [2,3].

Настоящая работа посвящается исследованию УbMgCu<sub>4</sub>. Этот материал относится к "легкой" ТФС. Стехиометрический YbMgCu<sub>4</sub>, согласно [1–4], имеет  $\gamma = 53-62 \text{ mJ/mol} \cdot \text{K}^2$ ,  $T_{\text{K}}$ , определенная из данных по магнитной восприимчивости, варьируется у него в пределах 500–855 K, валентность иона Yb изменяется от 2.63–2.65 при 4 K до 2.69–2.70 при 300 K, а постоянная Холла R<sub>H</sub> (в m<sup>3</sup>/C) составляет  $-(1.5-1.7) \cdot 10^{-10}$  при 4 K и  $-3.5 \cdot 10^{-10}$  при 300 K. Параметр элементарной ячейки у этих образцов равен 7.194 Å. Согласно данным  $R_{\text{H}}(T)$ , YbMgCu<sub>4</sub> является металлом.

В [7] на основании измерений коэффициента термоэдс было показано, что YbMgCu<sub>4</sub> имеет достаточно широкую область гомогенности, в пределах которой наблюдаются значительные изменения  $T_{\rm K}$ , но все составы, расположенные в этой области, относятся к тяжелофермионной системе. В качестве объекта настоящего исследования был выбран образец YbMgCu<sub>4</sub>, расположенный по своим свойствам в области гомогенности этого соединения.

В работе предполагалось провести измерение в интервале 5–300 К его теплопроводности ( $\varkappa$ ) и коэффициента удельного сопротивления ( $\rho$ ). Ранее измерения  $\varkappa(T)$ УbMgCu<sub>4</sub> не проводилось.

При исследовании  $\kappa(T)$  YbIn<sub>1-x</sub>Cu<sub>4+x</sub> [8–10], YbAgCu<sub>4</sub> [11], YbIn<sub>0.7</sub>Ag<sub>0.3</sub>Cu<sub>4</sub> [12], YbIn<sub>0.2</sub>Ag<sub>0.8</sub>Cu<sub>4</sub> [13], YbZnCu<sub>4</sub> [14] нами был обнаружен интересный эффект: фононная теплопроводность ( $\kappa_{ph}$ ) у этих соединений при  $T \geq 30-100$  К не уменьшалась с ростом температуры, как этого можно было ожидать для стандартных кристаллических твердых тел, а наоборот возрастала по закону  $\varkappa_{\rm ph} \sim T^n$  (где *n* изменялась в пределах от 0.13 до 0.8). Такое же поведение  $\varkappa_{\rm ph}$  было отмечено ранее в "легких" ТФС  ${\rm Sm}_{1-x}{\rm Gd}_x{\rm S}$  (при x > 0.16) [15], у "умеренной" ТФС UCu<sub>5</sub>In [16], т.е. и у этих материалов имело место "аморфноподобное" поведение  $\varkappa_{\rm ph}(T)$ . Общим для всех приведенных выше соединений было наличие в них ионов с переменной гомогенной валентностью (Sm, U), которые, по нашему мнению, и несут ответственность за "аморфноподобное" поведение  $\varkappa_{\rm ph}(T)$  этих материалов.

Основная цель настоящей работы состоит в исследовании поведения  $\varkappa_{\rm ph}(T)$  в случае YbMgCu<sub>4</sub>, входящего в "семью" соединений YbMCu<sub>4</sub>, но имеющего иные значения для  $T_{\rm K}$ ,  $\gamma$  и V по сравнению с исследованными нами ранее соединениями системы YbMCu<sub>4</sub>. Результаты такого исследования важны также для построения теории, которая смогла бы объяснить нестандартное поведение  $\varkappa_{\rm ph}(T)$  для кристаллических тел у этих материалов.

## 2. Приготовление образцов, методики исследования

Литые поликристаллические образцы приготовлялись по методике, описанной в [17]. При синтезе использовались дважды возогнанный и переплавленный в танталовом тигле (для очистки от окисла) Уb, Mg и Cu марки ОСЧ. Компоненты сплава в стехиомерическом соотношении переплавлялись в откачанном до  $\sim 10^{-4} \,\mathrm{mm \, Hg}$ тонкостенном (толщина стенок ~ 0.1 mm) заваренном танталовом контейнере. Плавление образцов проводилось в высокочастотной печи. Полученные образцы проходили рентгеноструктурный анализ на установке ДРОН-2 (в CuK<sub>a</sub>-излучении). Образец, выбранный для исследования, был монофазным, имел кубическую решетку типа AuBe<sub>5</sub> (структура C15b) и параметр элементарной ячейки (a) при 300 K, равный 7.161 Å, так что по составу этот образец располагался в пределах области гомогенности YbMgCu<sub>4</sub> [7]. Как отмечалось выше, параметр а у стехиометрического образца YbMgCu<sub>4</sub> составлял 7.194 Å [2]. Теплопроводность и удельное электросопротивление измерялись в интервале температур 5-300 К на установке, аналогичной [18], в вакууме  $\sim 10^{-5}$  mm Hg.

# Полученные результаты и их обсуждение

На рис. 1 приведены полученные экспериментальные результаты для полной теплопроводности  $\varkappa_{tot}(T)$ , а на рис. 2 — для  $\rho(T)$  исследованного образца YbMgCu<sub>4</sub>.

3.1. Удельное электросопротивление. Приведенные на рис. 2 значения  $\rho(T)$  для образца YbMgCu<sub>4</sub>, относящегося к области гомогенности этого соединения, по величине отличаются от  $\rho(T)$  стехиометрического



**Рис. 1.** Температурная зависимость общей теплопроводности ( $x_{tot}$ ) YbMgCu<sub>4</sub>.



**Рис. 2.** Температурная зависимость удельного электросопротивления YbMgCu<sub>4</sub>. На вставке приведены значения  $\rho(T)$  для стехиометрического образца YbMgCu<sub>4</sub> из работы [2].



**Рис. 3.** Температурная зависимость отношения  $\rho(T)/\rho(300 \text{ K})$  для образцов YbMgCu<sub>4</sub>, исследованных в [2] (1) и настоящей работе (2).

образца YbMgCu<sub>4</sub> из [2] (см. вставку к рис. 2), но по характеру температурной зависимости они идентичны друг другу. Это подтверждается данными, представленными на рис. 3. Значения  $\rho(T)/\rho(300 \text{ K})$  для образцов YbMgCu<sub>4</sub>, исследованных нами и в работе [2], совпали между собой.

На рис. 4 приведена зависимость  $\rho(T)$  для исследованного образца YbMgCu<sub>4</sub> в логарифмических координатах. Величина остаточного сопротивления для этого образца оказалась равной ~  $21.5 \mu \Omega \cdot \text{cm}$ .

3.2. Теплопроводность. Как уже отмечалось выше, исследованный образец YbMgCu<sub>4</sub> можно отнести к металлам, для которых общая теплопроводнось  $\varkappa_{tot}$ выражается в виде суммы решеточной (фононной)  $\varkappa_{ph}$ и электронной  $\varkappa_e$  составляющих теплопроводности [19]:

$$\varkappa_{\text{tot}} = \varkappa_{\text{ph}} + \varkappa_e.$$
(1)

 $\varkappa_e$  подчиняется закону Видемана–Франца и записывается в виде

$$\varkappa_e = L_0 T / \rho, \qquad (2)$$

где  $L_0$  — зоммерфельдовское значение числа Лоренца. Для металлов и полуметаллов оно равно  $2.45 \cdot 10^{-8} \text{ W}\Omega/\text{K}^2$ .

На рис. 5 приведены результаты расчета  $\varkappa_{\rm ph}(T)$  с помощью формул (1) и (2). Как видно из этого рисунка, кристаллический YbMgCu4 имеет аморфноподобную температурную зависимость  $\varkappa_{\rm ph}(T)$ . Ее вид похож на поведение  $\varkappa_{\rm ph}(T)$  классических аморфных твердых тел, относящихся к участкам I-3 кривой, представленной на вставке к рис. 5. Она согласуется также с полученными нами ранее данными об аморфноподобном поведении  $\varkappa_{\rm ph}(T)$  YbIn<sub>1-x</sub>Cu<sub>4+x</sub> [8–10], YbAgCu<sub>4</sub> [11], YbIn<sub>0.7</sub>Ag<sub>0.3</sub>Cu<sub>4</sub> [12] и особенно YbIn<sub>0.2</sub>Ag<sub>0.8</sub>Cu<sub>4</sub> [13] и YbZnCu<sub>4</sub> [14] (рис. 6).

Таким образом, можно снова констатировать, что с большой вероятностью обнаруженный эффект аморфноподобного поведения  $\varkappa_{\rm ph}(T)$  в основном связан с



**Рис. 4.** Зависимость  $\rho(T)$  для исследованного образца YbMgCu<sub>4</sub> в логарифмических координатах.



**Рис. 5.** Температурная зависимость  $\kappa_{ph}$  для исследованного образца YbMgCu<sub>4</sub>. На вставке представлено схематическое изображение температурной зависимости  $\kappa_{ph}$  для классических аморфных материалов.



**Рис. 6.** Температурные зависимости  $\kappa_{ph}$  для YbIn<sub>0.2</sub>Ag<sub>0.8</sub>Cu<sub>4</sub> [13], YbZnCu<sub>4</sub> [14] и исследованного нами образца YbMgCu<sub>4</sub>. Стрелки на кривых ограничивают область слабой температурной зависимости представленных материалов.

наличием в этих материалах иона Yb с гомогенной переменной валентностью и практически не зависит от величин  $T_{\rm K}$  и  $\gamma$  исследованных материалов.

#### 4. Заключение

Отметим основные результаты, полученные в настоящей работе.

1) В интервале температур 5-300 К на литом поликристаллическом образце YbMgCu<sub>4</sub> с a = 7.161 Å, расположенном в области гомогенности этого соединения, измерены теплопроводность и удельное электросопротивление. 2) Для исследованного кристаллического образца YbMgCu<sub>4</sub> обнаружено "аморфноподобное" поведение фононной теплопроводности, обусловленное в основном наличием в нем иона Yb с гомогенной переменной валентностью.

Сделано заключение, что эффект аморфноподобного поведения  $\varkappa_{\rm ph}(T)$  практически не зависит от величины  $T_{\rm K}$  и  $\gamma$  у различных материалов системы YbMCu<sub>4</sub>.

Авторы выражают благодарность Н.Ф. Картенко и Н.В. Шаренковой за проведение рентгеноструктурного анализа исследованных образцов.

### Список литературы

- E. Fugiera, J.M. Lowrence, J.L. Sarrao, Z. Fizk, M.F. Hundley, J.D. Thompson. Solid State Commun. 106, 347 (1998).
- [2] J.L. Sarrao, C.D. Immer, Z. Fizk, C.H. Booth, E.Figueroa, J.M. Lowrence, R. Modler, A.L. Cornelius, M.F. Hundkey, J.H. Kwei, J.D. Thompson, F. Bridges. Phys. Rev. B 59, 6855 (1999).
- [3] J.M. Lowrence, P.S. Riseborough, C.H. Booth, J.L. Sarrao, J.D. Thompson, R. Osbern. Phys. Rev. B 63, 054 427 (2001).
- [4] T. Kojima, M. Matsumoto, T. Tanaka, H. Ishida, T. Mito, S. Wada, J.L. Sarrao. Phys. Rev. B 66, 014 420 (2002).
- [5] V.N. Antonov, M. Galli, F. Marabelli, A.N. Yeresko, A.Ya. Perlov, E. Bauer. Phys. Rev. B 62, 1742 (2000).
- [6] H. Sato, K. Hiraoka, T. Taniguchi, Y. Nishikawa, F. Nagasaki, H. Fujino, Y. Takeda, M. Arita, K. Shimada, H. Namatame, A. Kimura, K. Kojima. J. Phys.: Cond. Matter. 14, 4445 (2002).
- [7] А.В. Голубков, А.В. Гольцев, Н.Ф. Картенко, И.А. Смирнов, Cz. Sulkowski, H. Misiorek. ФТТ 49, 1159 (2007).
- [8] И.А. Смирнов, Л.С. Парфеньева, А. Ежовский, Х. Мисиорек, С. Кремпел-Хассе, Ф. Риттер, В. Ассмус. ФТТ 41, 1548 (1999).
- [9] А.В. Голубков, Л.С. Парфеньева, И.А. Смирнов, Х. Мисиорек, Я. Муха, А. Ежовский, Ф. Риттер, В. Ассмус. ФТТ 44, 973 (2002).
- [10] Л.С. Парфеньева, И.А. Смирнов, Х. Мисиорек, Я. Муха, А. Ежовский, Ф. Риттер, В. Ассмус. ФТТ 44, 1162 (2002).
- [11] А.В. Голубков, Л.С. Парфеньева, И.А. Смирнов, Х. Мисиорек, Я. Муха, А. Ежовский. ФТТ 43, 210 (2001).
- [12] А.В. Голубков, Л.С. Парфеньева, И.А. Смирнов, Х. Мисиорек, Я. Муха, А. Ежовский. ФТТ 43, 1739 (2001).
- [13] А.В. Голубков, Л.С. Парфеньева, И.А. Смирнов, Н. Misiorek, J. Mucha, A. Jezowski. ФТТ **48**, 586 (2006).
- [14] А.В. Голубков, Л.С. Парфеньева, И.А. Смирнов, Н. Misiorek, J. Mucha, A. Jezowski. ФТТ **49**, 19 (2007).
- [15] Л.С. Парфеньева, И.А. Смирнов, Х. Мисиорек, Я. Муха, А. Ежовский. ФТТ 42, 986 (2000).
- [16] D. Kaczorowski, R. Troc, A. Czopnik, A. Jezowski, Z. Henkie, V.I. Zeremba. Phys. Rev. B 63, 144 401 (2001).
- [17] А.В. Голубков, Т.Б. Жукова, В.М. Сергеева. Изв. АН СССР. Неорган. материалы 2, 77 (1966).
- [18] A. Jezowski, J. Mucha, G. Pompe. J. Phys. D: Appl. Phys, 20, 1500 (1987).
- [19] И.А. Смирнов, В.И. Тамарченко. Электронная теплопроводность в металлах и полупроводниках. Наука, Л. (1977). 151 с.